

即時發布

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Becky Howland 博士

企業傳播資深總監

(408) 875-9350

becky.howland@kla-tencor.com

KLA-Tencor 發布 Voyager™ 1015 和 Surfscan® SP7 缺陷檢測系統： 解決製程和設備監控中的兩個關鍵挑戰

加利福尼亞州米爾皮塔斯，2018 年 7 月 10 日 -- 今天，[KLA-Tencor 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）宣布推出兩款全新缺陷檢測產品，在矽晶圓和晶片製造領域中針對尖端邏輯和記憶體節點，為設備和製程監控解決兩個關鍵挑戰。Voyager™ 1015 系統提供了檢測圖案化晶圓的新功能，包括在光阻顯影後並且晶圓尚可重做的情況下，立即在微影單元中進行檢查。Surfscan® SP7 系統為裸晶圓、平滑和粗糙的薄膜提供了前所未有的缺陷檢測靈敏度，這對於製造用於 7nm 邏輯和高級記憶體器件節點的矽基底非常重要，同時也是在晶片製造中及早發現製程問題的關鍵。這兩款新的檢測系統都旨在通過從根源上捕捉缺陷偏移，以加快創新電子元件的上市時間。

“在領先的 IC 技術中，晶圓和晶片製造商幾乎沒有出錯的空間，” KLA-Tencor 資深副總裁兼首席營銷官 Oreste Donzella 說。“新一代晶片的臨界線寬非常小，以至於在裸矽晶片或薄膜監測晶圓上，那些可以導致良率損失的缺陷尺寸已經小於現有設備監測系統的檢測極限。此外，無論是 193i 還是 EUV，缺陷檢測領域的第二個關鍵是如何可靠地檢測到微影製程早期所引入的良率損失缺陷。我們的工程團隊開發出兩種新的缺陷檢測系統 - 一種用於無圖案/控片晶圓，一種用於圖案化晶圓 - 為工程師快速並準確地解決這些難題提供關鍵的一臂之力。”

Surfscan SP7 無圖案晶圓缺陷檢測系統採用實質性創新的光源和感測器架構，並實現了足以改變行業面貌的靈敏度，其分辨率與前一代市場領先的 Surfscan 系統相比有著劃時代的提升。這種前所未有的解決方案的躍進是檢測那些最小的殺手缺陷的關鍵。新分辨率的範圍可以允許對許多缺陷類型（如顆粒，划痕，滑移線和疊差）進行即時分類 - 無需從 Surfscan 設備中取出晶圓或影響系統產出率。同時，對峰值功率密度的精確控制也使得 Surfscan SP7 能夠檢測薄而脆弱的 EUV 光阻材料。

Voyager 1015 圖案化晶圓缺陷檢測系統採用新型光源、訊號擷取和感測器架構，填補了顯影後檢測（ADI）方面的長期缺口。這種革命性的激光散射檢測系統在提升靈敏度的同時也可以

減少干擾點訊號 - 並且與次佳產品相比得到檢測結果要迅速得多。與新型 Surfscan SP7 一樣，Voyager 系統具有功率密度的優異控制功能，可在顯影後對敏感光阻材料進行在線檢測。在微影單元和晶圓廠其他模組中對關鍵缺陷進行高效率擷取，使得製程問題可以被快速辨識和修正。

第一批 Surfscan SP7 和 Voyager 1015 系統已在全球領先的晶圓、設備和晶片製造商的工廠中運行，與 KLA-Tencor 的 eDR[®] 電子顯微系統以及 Klarity[®] 數據分析系統一起，用以從根源識別製程控制的問題。為了保持晶圓和晶片製造商的高性能和生產力，Voyager 和 Surfscan SP7 系統由 [KLA-Tencor 全球綜合服務網絡](#) 提供技術支持。有關這兩個新缺陷檢測系統的更多信息，請參閱 [Voyager 1015-Surfscan SP7 發布信息頁面](#)。

關於 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是全球領先的製程控制及良率管理解決方案的設備供應商。該公司與全球的客戶合作，開發最先進的檢測和量測技術，致力服務於半導體、LED 等相關納米電子工業。憑藉業界標準產品組合和世界一流的工程師科學家團隊，公司 40 餘年來持續為客戶打造卓越的解決方案。KLA-Tencor 公司的總部位於加利福尼亞州米爾皮塔斯市 (Milpitas)，並在全球設有專屬的客戶運營和服務中心。更多相關信息，請訪問公司網站 <http://www.kla-tencor.com/> (KLAC-P)。

前瞻性聲明:

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Voyager 1015 和 Surfscan SP7 系統的預期性能以及缺陷減少為晶圓、設備、材料和晶片製造設施所帶來的經濟影響都是前瞻性陳述，並且並符合《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中“安全港”(Safe Harbor) 條款的規定。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，並且受到諸多風險與不確定性影響。由於各種實際因素，例如（由於成本、功能問題或其他原因造成的）新技術推遲、其他公司推出競爭性產品、或影響 KLA-Tencor 產品的實施、性能或使用的意外技術挑戰或限制等影響，實際結果可能與此類聲明中的預計結果大不相同。

###